

2025

半導體IC晶片封裝製程 技術菁英人才培育計畫



日期

114年7月17日(四)
7月18日(五)



地點

明新學校財團法
人明新科技大學
半導體學院

主辦單位：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學
明新學校財團法人明新科技大學半導體學院

協辦單位：美銘國際科技有限公司
力成科技股份有限公司